

3C 分析レポート：電子部品製造業

【Customer】市場・顧客

- 主な顧客：自動車、家電、産業機械、医療機器メーカーなど。
- ニーズ変化：コスト重視から信頼性・ESG・トレーサビリティ重視へ移行。
- 潜在的顧客層：脱炭素対応やミリ波・センサー・IoT 部品を求める新興ベンチャー・大学発企業など。
- 注目のニッチ：ドローン、ロボット、宇宙機器分野などにおける高精度・小型化部品の特需発生可能性。
- 顧客側の課題：部品供給の安定性・短納期対応・共創パートナーとしての技術力の可視化ニーズが拡大中。

【Competitor】競合

- 国内競合：中堅製造業や EMS（電子機器受託生産）企業との価格・納期競争が激化。
- 海外競合：中国・台湾・韓国に加え、インド・ベトナム企業がコスト優位で台頭。
- 技術競合：AI 設計・3D プリンティングを活用した“設計から生産までの短縮型メーカー”の登場。
- 間接競合：セットメーカーの内製化や、生成 AI による設計自動化が一部の外注需要を吸収する可能性。
- 見落とされがちな競合：研究機関やスタートアップによる素材開発・量産化が、既存技術のコモディティ化を引き起こす可能性。

【Company】自社

- 経営資源：熟練工による品質対応力、短納期対応、小ロット多品種対応力。
- 差別化要因：開発フェーズからの関与、現場での課題解決力、部品調達・加工・評価までの一貫性。
- 組織文化：“現場対応力”に偏重しており、データドリブン経営や人材多様性が未成熟。
- 改善余地：営業力・ブランド力の強化、設計最適化と生産性の見える化、デジタル人材の中途採用と社内育成。
- 潜在資産：海外拠点を活かした地域間生産最適化、技能動画による DX 研修サービスなど事業展開の可能性。